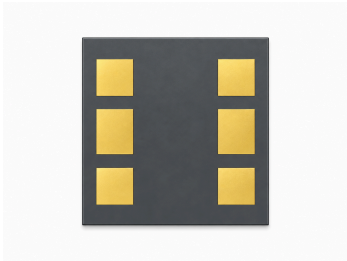


10 pF Chip condensador de GaAs

Capacitancia: 10 pF (típico); Tensión soportada: 50 V (típico). Dimensiones del die: 0.5 × 0.5 × 0.1 mm.



Características eléctricas · TA = +25 °C

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Capacitancia	-	-	10	-	pF
Tensión soportada	-	-	50	-	V

Valores límite

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Valor	Unidad
Tensión de ruptura	-	-	-	-	80 (Vb)	V

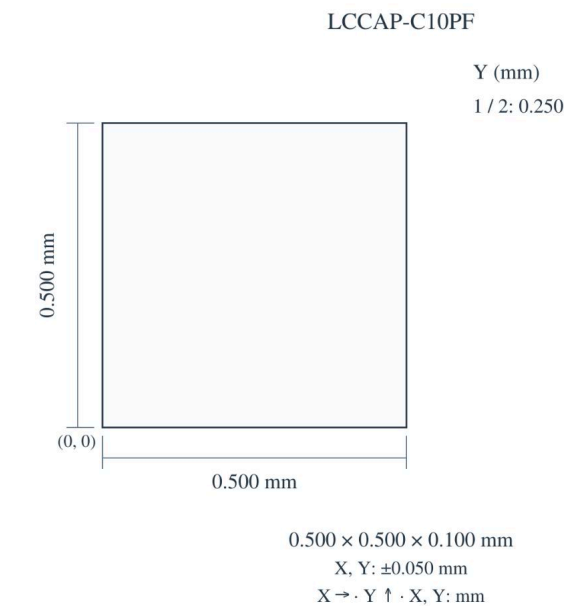
Condiciones ambientales

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Temperatura de almacenamiento	-	-65	-	150	°C
Temperatura de funcionamiento	-	-55	-	125	°C

Dimensiones del chip

Parámetro	Valor	Unidad
Dimensiones del chip	0.5 × 0.5 × 0.1	mm

Plano dimensional mecánico



Todas las dimensiones se indican en mm [in].

Asignación de pads de unión

Terminales	Símbolo	Función	Notas
1, 2	IN/OUT	Entrada/salida recíproca	-
Cara posterior del chip	GND	Masa	RF / DC GND

Registro de la publicación actual · 1.1 · 2026-10-23. Actualización de las tablas de especificaciones. Sustituye a la revisión 1.0.

Integración del chip y secuencia de polarización

La cara posterior del chip requiere una conexión a tierra fiable.

Alcance de la referencia mecánica

Guía dimensional en mm basada en la documentación de origen. Información parcial; no constituye un plano completo de fabricación o de unión por hilos.

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.